



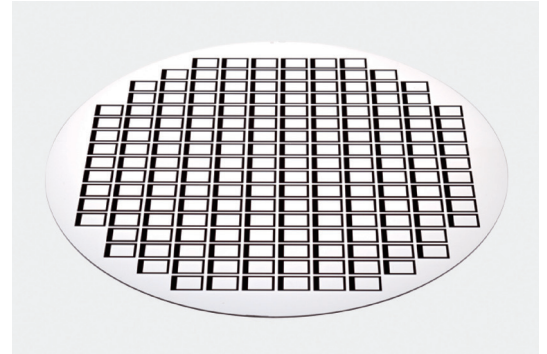
MATERION

BALZERS OPTICS

# 晶圆级封装

## 晶圆级封装用于先进光学半导体封装

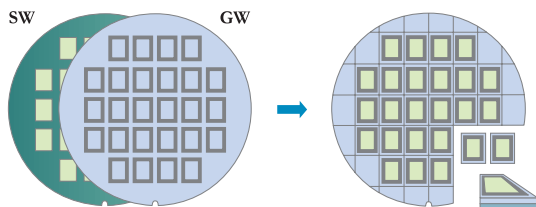
美题隆精密光学晶圆级封装是高产量先进光学分装的前沿技术。我们可以提供玻璃晶圆与硅片在切割前键合的解决方案，并且有些应用需要两个晶圆之间有一个间隔层我们也可以提供解决方案。我们除了提供具有低缺陷光学镀膜的高质量玻璃晶圆外，如果需要，也可利用我们半导体级别光刻技术提供镀铬孔图形，帮助客户用于光束整形。



### 优点

- 半导体级别洁净车间
- 低缺陷光学镀膜，晶圆上芯片光圈良率高
- 一站式镀膜与封装盖方案，减少晶圆封装步骤
- 平行装配步骤，综合成本低
- 帮助客户芯片集成化

### 晶圆级分装原理图

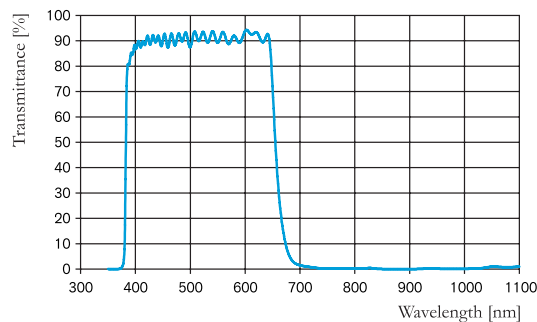


带有传感器阵列的整个半导体晶圆 (SW) 被一个玻璃晶圆 (GW) 覆盖

组合的晶圆被切割成芯片

### 应用 / 技术参数

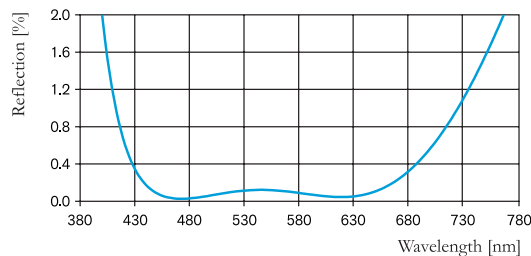
#### 晶圆级别的红外截止镀膜



#### CMOS 封装

晶圆尺寸	直径 200mm, 厚度 0.3/0.4mm
典型玻璃类型	硼硅酸盐玻璃 Schott D263T
缺陷等级	无大于 50 微米缺陷

#### 晶圆级别的抗反射镀膜



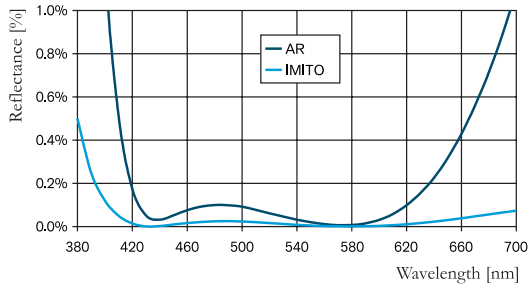
#### MEMS/CMOS 封装

晶圆尺寸	直径 200mm, 厚度 1.1mm
典型玻璃类型	浮法玻璃 Eagle XG, AF32
缺陷等级	无大于 20 微米缺陷

美题隆精密光学 (上海) 有限公司  
 上海浦东新区中国 (上海) 自由贸易区  
 富特东三路 76 号 33 号楼  
 邮编: 200131

上海  
 电话: 021 60574646  
 info.mbo@materion.com  
 www.materion.com/balzersoptics

### 晶圆级别的介质匹配导电膜



### LCOS 封装

晶圆尺寸	直径 200mm, 厚度 0.7/1.1mm
典型玻璃类型	浮法玻璃 Eagle XG, AF32
缺陷等级	在 ITO 镀膜面无大于 10 微米的缺陷

美题隆精密光学（上海）有限公司  
上海浦东新区中国（上海）自由贸易区  
富特东三路 76 号 33 号楼  
邮编：200131

上海  
电话：021 60574646  
info.mbo@materion.com  
www.materion.com/balzersoptics